

2010年度決算説明会

2011年4月28日

株式会社村田製作所



謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。

**このたびの東日本大震災により
被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。**

一日も早い被災地の復旧を心より祈念いたします。

株式会社 村田製作所

1. 2010年度 業績概要

2010年4月～2011年3月
連結累計期間

東日本大震災の影響＜復旧状況＞

1. 登米村田製作所(宮城県登米市)

＜生産品目:コイル、EMI除去フィルタ＞

- ・人的被害なし。建物、設備の一部で損傷あり。
- ・3月29日より一部生産再開し、4月18日に復旧完了済。

2. 金沢村田製作所仙台工場(宮城県仙台市)

＜生産品目:表面波フィルタ＞

- ・人的被害なし。建物、設備の一部で損傷あり。
- ・金沢村田製作所(石川県白山市)で代替生産中。
- ・仙台工場は、5月中に生産再開予定。

3. 村田製作所小山工場(栃木県小山市)

＜生産品目:機能性高分子アルミ電解コンデンサ＞

- ・人的被害なし。建物、設備の一部で損傷あり。
- ・3月28日より生産再開し、復旧完了済。

東日本大震災の影響＜影響額＞

＜2010年度影響額＞

1. 売上高減・・・約▲10億円
 - ・登米村田製品の売上減
2. 災害関連費用(営業利益減)・・・約▲8億円
 - ・棚卸資産の廃棄額
 - ・建物、インフラ、設備の修繕費用
 - ・操業ロス 他

業績概況(2010年度通期)

	2009年度 通期		2010年度 通期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	5,308	100.0	6,180	100.0	+871	+16.4
営業利益	267	5.0	775	12.5	+508	+189.9
税引前 当期純利益	347	6.5	821	13.3	+474	+136.8
当期純利益	248	4.7	535	8.7	+287	+116.1

製品別売上高(2010年度通期)

	2009年度		2010年度		増減	
	通期		通期			
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	1,789	33.8	2,214	36.0	+426	+23.8
圧電製品	823	15.6	864	14.0	+42	+5.1
その他コンポーネント	982	18.6	1,170	19.0	+188	+19.1
通信モジュール	1,231	23.2	1,383	22.5	+152	+12.4
電源他モジュール	464	8.8	525	8.5	+61	+13.2
製品売上高計	5,288	100.0	6,156	100.0	+868	+16.4

製品別売上高概況

コンデンサ (前期比+23.8%)	＜チップ積層セラミックコンデンサ＞ セット台数増、員数増、品種構成良化(小型・大容量)により大幅増
圧電製品 (前期比+5.1%)	＜表面波フィルタ＞ 携帯電話・データカード台数増、員数増により大幅増 ＜セラミック発振子＞ 主力のカーエレ含む全用途で増加 ＜ショックセンサ＞ TPMS向け大幅増 ＜超音波センサ＞ バックソナー向け大幅増
その他コンポーネント (前期比+19.1%)	＜EMI 除去フィルタ＞ セット台数増により大幅増 ＜コイル＞ 携帯電話台数増、員数増により大幅増 ＜コネクタ＞ 携帯電話、タブレットPC向け大幅増 ＜サーミスタ＞ 家電、スマートフォン向け大幅増
通信モジュール (前期比+12.4%)	＜無線LANモジュール＞ スマートフォン向け大幅増
電源他モジュール (前期比+13.2%)	＜電源＞ プリンタ、コピー機、サーバー向け増加

用途別売上高(2010年度通期)

	2009年度		2010年度		増減	
	通期		通期			
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	801	15.1	793	12.9	▲7	▲0.9
通信	2,288	43.3	2,700	43.9	+412	+18.0
コンピュータ 及び関連機器	942	17.8	1,141	18.5	+199	+21.1
カーエレクトロニクス	665	12.6	797	12.9	+132	+19.8
家電・その他	592	11.2	725	11.8	+133	+22.4
用途別売上高計	5,288	100.0	6,156	100.0	+868	+16.4

(注) 当社推計値に基づいております

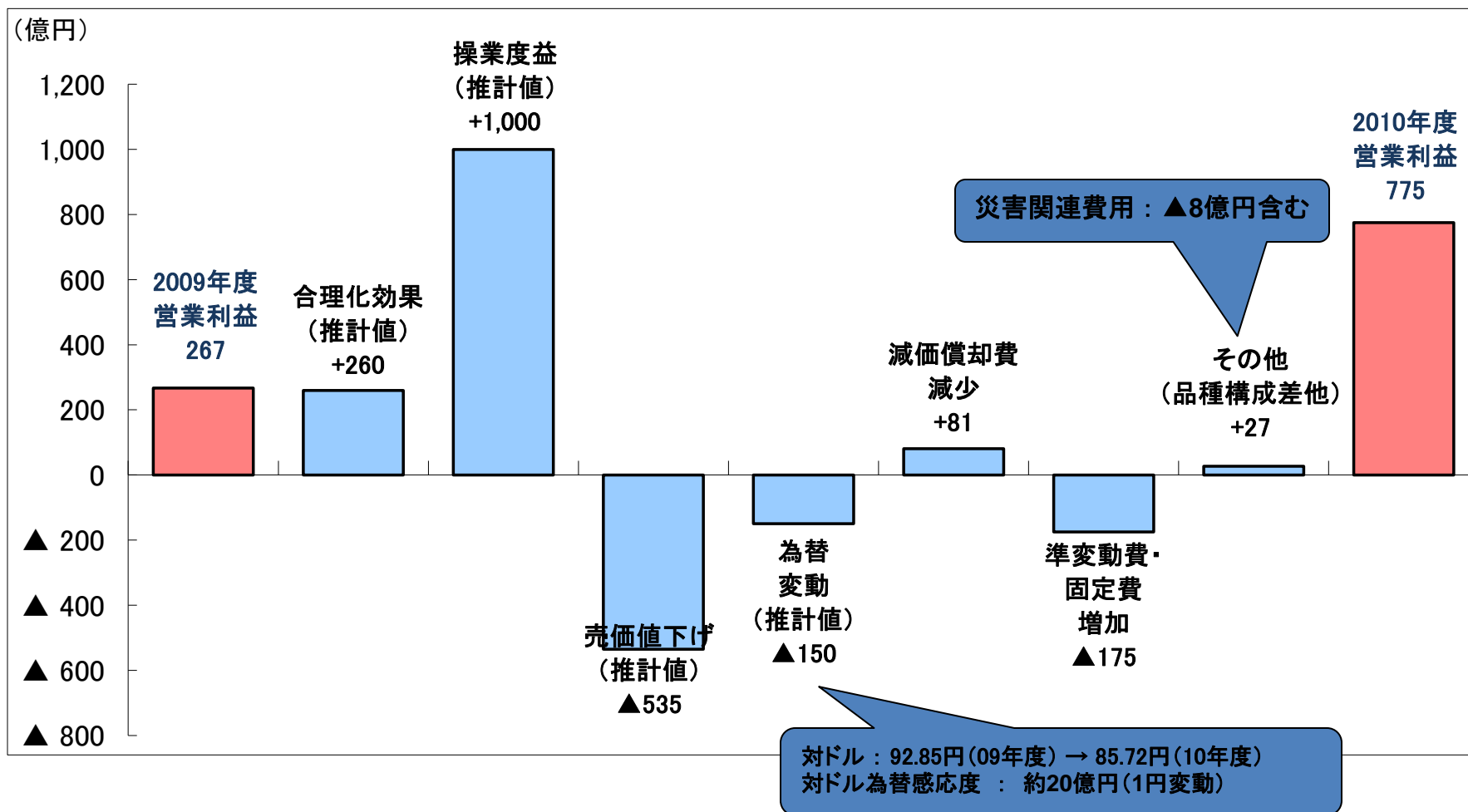
用途別売上高概況

<p>AV (前期比▲0.9%)</p>	<p>＜薄型テレビ＞ MLCC大幅増 ＜携帯メディアプレイヤー＞ 圧電スピーカ大幅減、無線LANモジュール減少</p>
<p>通信 (前期比+18.0%)</p>	<p>無線LANモジュール、MLCC、表面波フィルタ、ノイズ対策部品、コネクタ大幅増</p>
<p>コンピュータ及び 関連機器 (前期比+21.1%)</p>	<p>MLCC、電源、通信機器用モジュール、コネクタ、多層デバイス大幅増</p>
<p>カーエレクトロニクス (前期比+19.8%)</p>	<p>Bluetoothモジュール、MLCC、LTCC基板、超音波センサ大幅増</p>

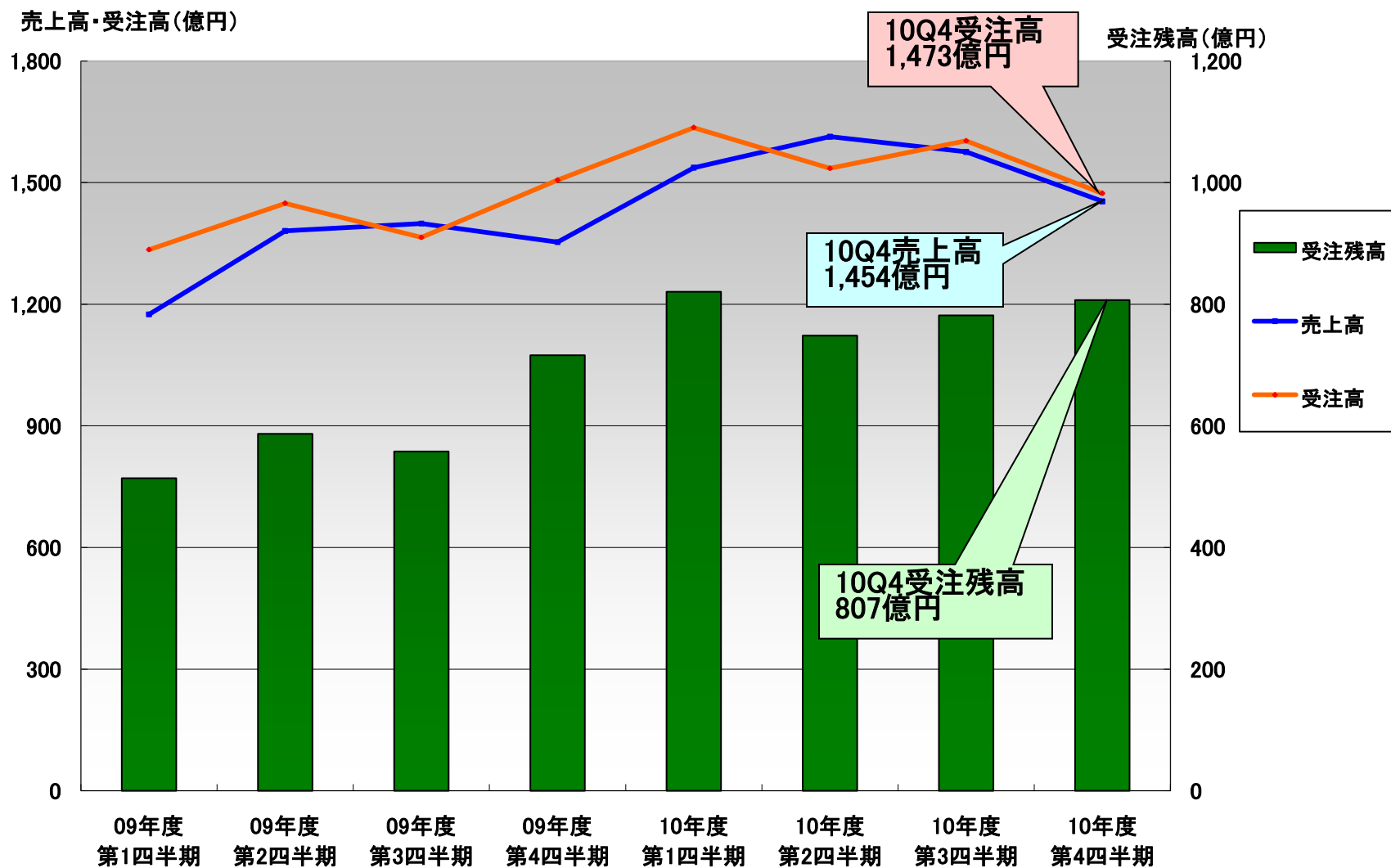
(注) 当社推計値に基づいております

利益変動要因

(2009年度→2010年度)



売上・受注・注残推移(四半期)

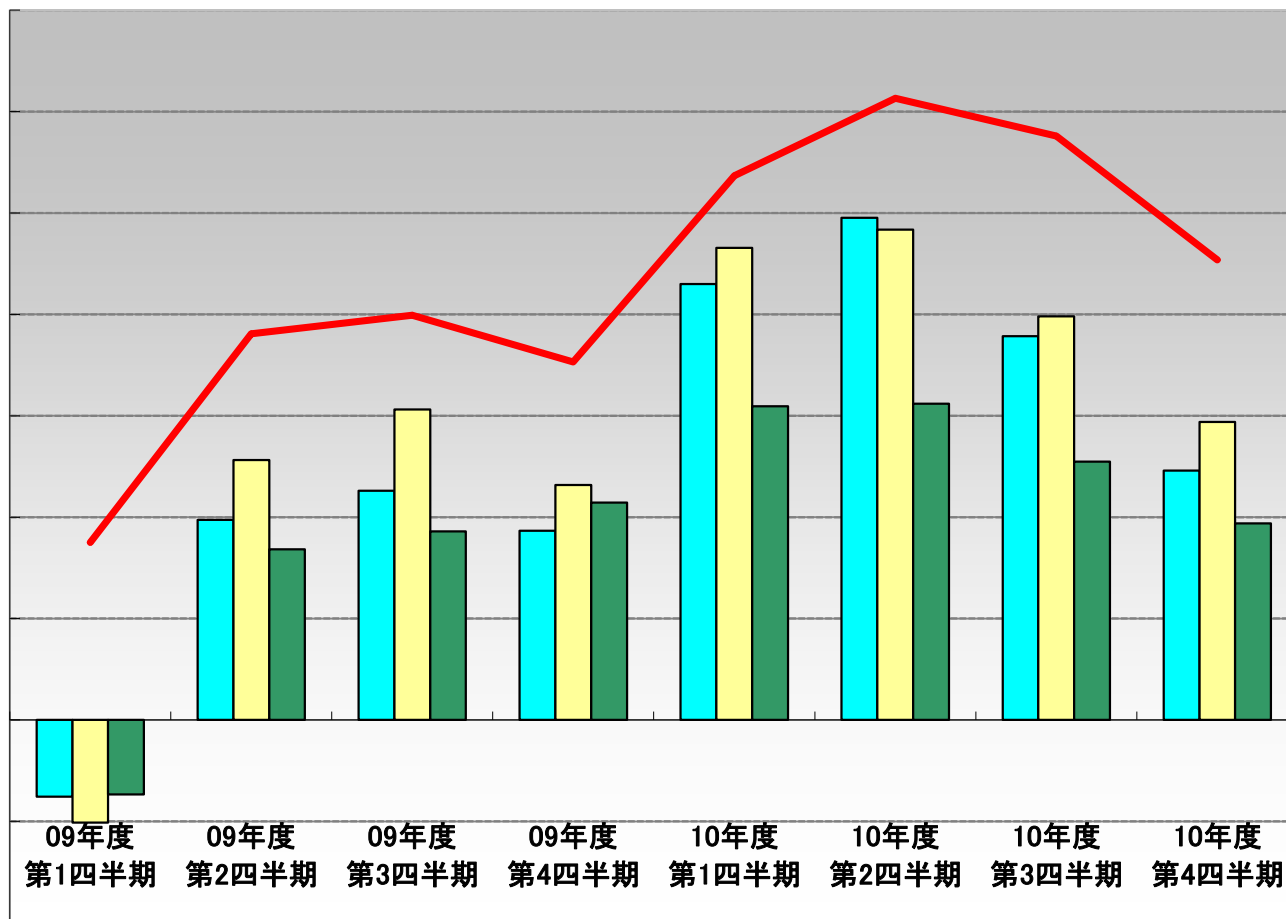


業績推移(四半期)

(億円)

営業利益・税引前四半期純利益・四半期純利益

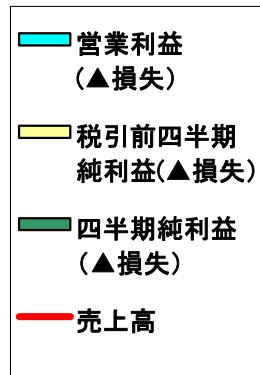
350
300
250
200
150
100
50
0
▲50
▲100



(億円)

売上高

1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200



2. 2011年度 業績予想 (2011年4月～2012年3月)

部品需要予測(AV、通信)

薄型TV

2.1億台(2010年度) → 2.2億台(2011年度)
+5%

携帯電話

14.1億台(2010年度) → 15.5億台(2011年度)
+10%

うち、

2G : 9.8億台(2010年度) → 9.5億台(2011年度)
▲3%

3G : 4.3億台(2010年度) → 6.0億台(2011年度)
+40%

スマートフォン : 3.2億台(2010年度) → 4.8億台(2011年度)
+50%

部品需要予測(PC及び関連機器)

PC

3.7億台(2010年度) → 4.0億台(2011年度)
+8%

うち、

デスクトップ : 1.4億台(2010年度) → 1.3億台(2011年度)
▲7%

ノートブック : 2.0億台(2010年度) → 2.1億台(2011年度)
+5%

タブレット : 0.3億台(2010年度) → 0.6億台(2011年度)
2倍

製品別売上予想

	2010年度実績 (前期比)	2011年度予想 (前期比)
コンデンサ	+23.8%	+8%程度
圧電製品	+5.1%	▲4%程度
その他コンポーネント	+19.1%	+10%程度
通信モジュール	+12.4%	+5%程度
電源他モジュール	+13.2%	▲2%程度
計	+16.4%	+5%

用途別売上予想

	2010年度実績 (前期比)	2011年度予想 (前期比)
AV	▲0.9%	▲3%程度
通信	+18.0%	+10%程度
コンピュータ 及び関連機器	+21.1%	+5%程度
カーエレクトロニクス	+19.8%	+2%程度
家電・その他	+22.4%	横這い
計	+16.4%	+5%

(注) 当社推計値に基づいております

2011年度の業績予想

	2010年度		2011年度				増減	
	実績		上期 予想	下期 予想	通期予想			
	金額	構成比	金額	金額	金額	構成比	金額	伸率
	(億円)	(%)	(億円)	(億円)	(億円)		(億円)	(%)
売上高	6,180	100.0	3,100	3,400	6,500	100.0	+320	+5.2
営業利益	775	12.5	400	440	840	12.9	+65	+8.4
税引前 当期純利益	821	13.3	430	460	890	13.7	+69	+8.5
当期純利益	535	8.7	280	300	580	8.9	+45	+8.4

東日本大震災の影響＜影響額＞

＜2011年度影響額＞

売上高減・・・約▲380億円

①セット生産台数の減少影響

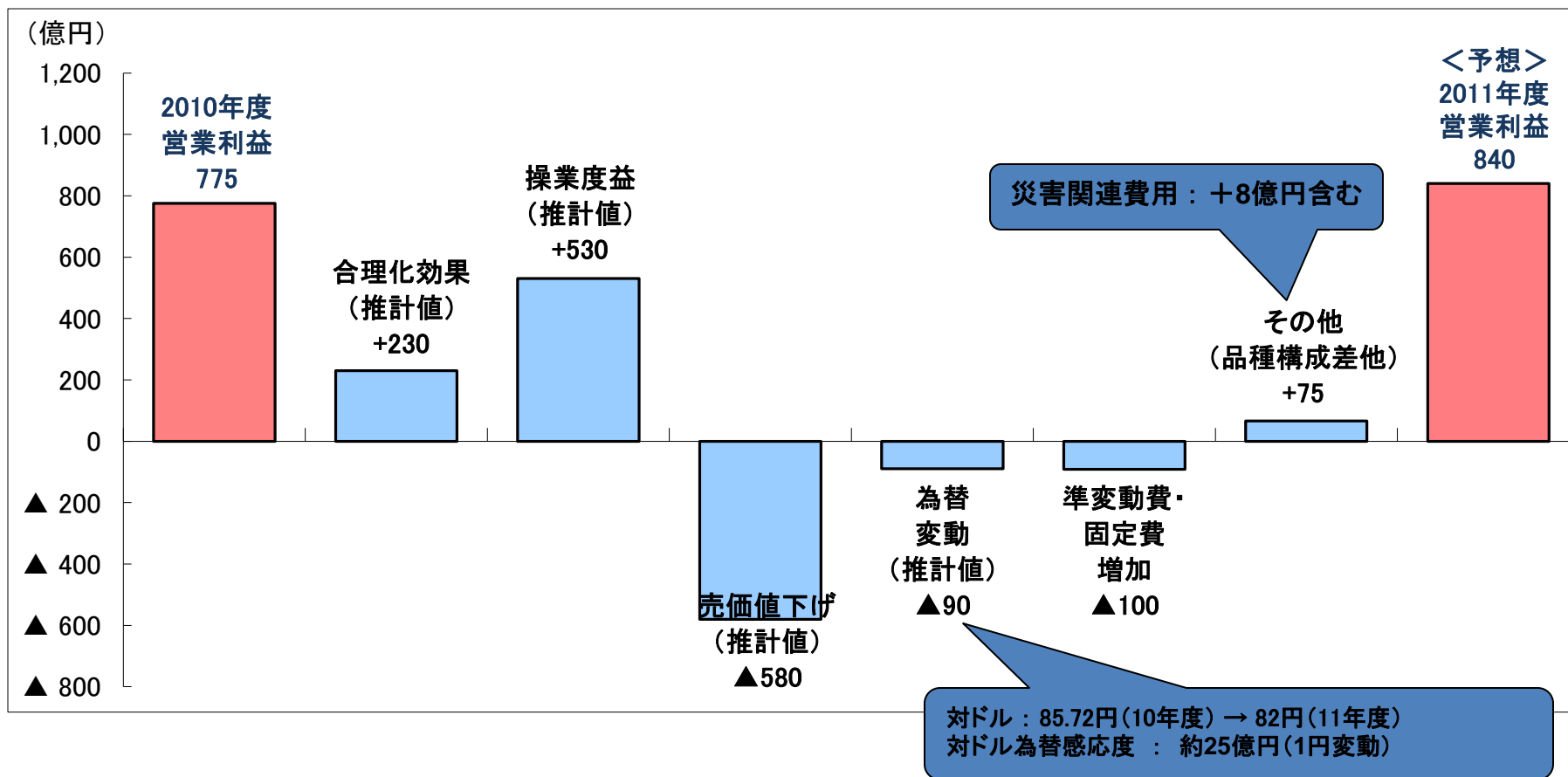
上期・・・約▲300億円、下期・・・約▲50億円

②当社部資材不足による減少影響

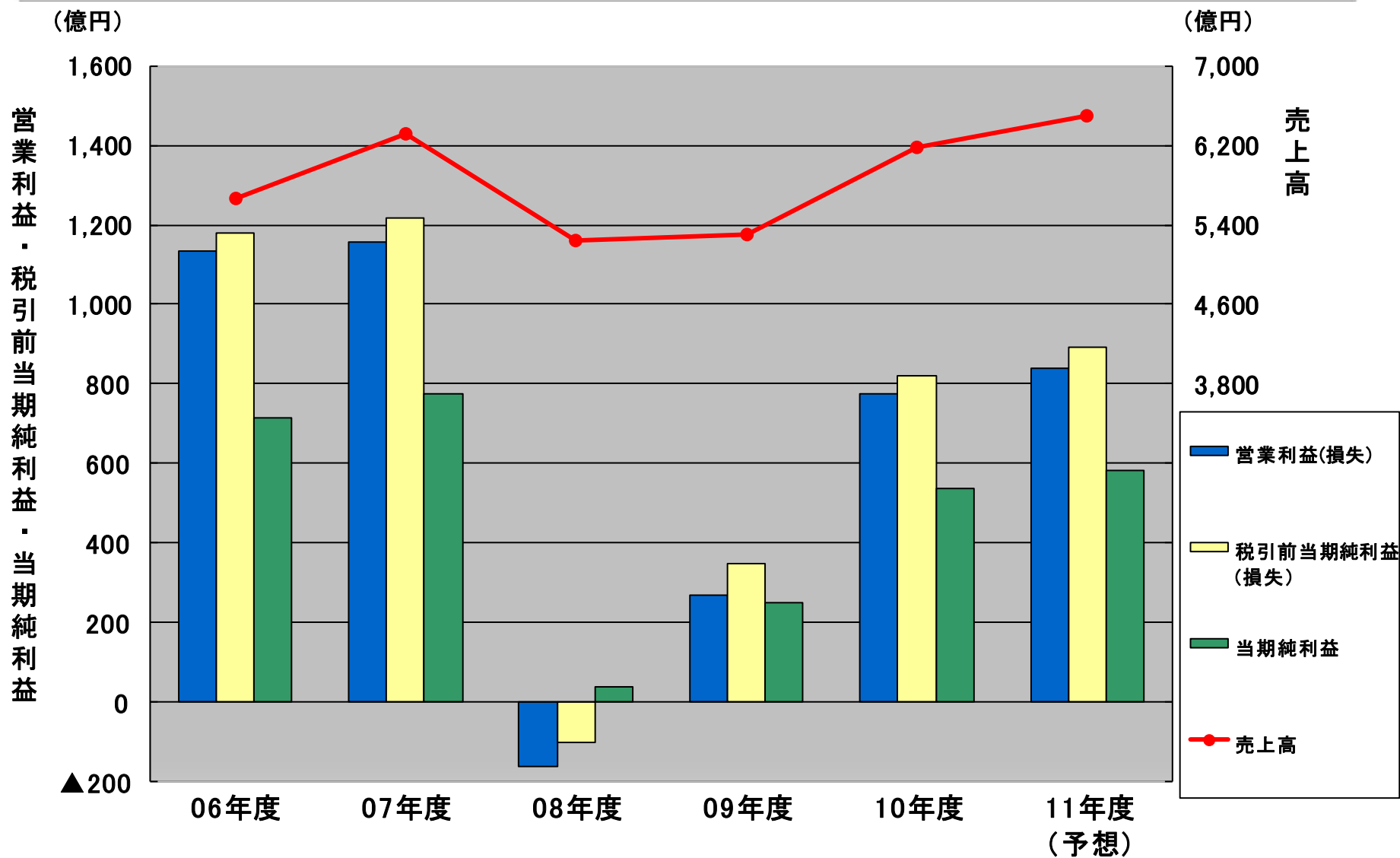
上期・・・約▲30億円

利益変動要因

(2010年度→2011年度)



業績推移(通期)



業績予想の前提

	2010年度 実績	2011年度 予想
減価償却費	618億円	620億円
研究開発費	398億円	430億円
設備投資額	568億円	700億円
為替レート(対米ドル)	85.72円	82.00円
為替レート(対ユーロ)	113.13円	118.00円

2011年度(2012年3月期)の配当(予定)
1株当たり年間100円(うち中間配当50円)

2010年度(2011年3月期)の配当
1株当たり年間100円
(中間配当50円/期末配当予定50円)

※当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものであります。

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。